

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-525008 (P2004-525008A)
 【公表日】平成 16 年 8 月 19 日 (2004.8.19)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-032
 【出願番号】特願 2002-586693 (P2002-586693)
 【国際特許分類第 7 版】

B 4 1 J 2/16

B 4 1 J 2/05

【F I】

B 4 1 J 3/04 1 0 3 H

B 4 1 J 3/04 1 0 3 B

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 4 月 21 日 (2005.4.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電気回路デバイスとフレキシブルテープ回路との間の露出した導電接続部を電気泳動めっきによって腐食環境から保護するステップを含み、

前記露出した接続部は凹凸のある平面を有し、該凹凸のある平面を厚さが均一の絶縁薄膜で覆う方法であって、

前記露出した接続部上に第 1 の電位を設定するステップと、

前記電気回路デバイスの少なくとも露出された接続部を、第 2 の電位の電極と接触する電気泳動用の溶液に浸すステップとを含み、前記第 1 の電位は第 2 の電位と等しくなく、それにより前記電極と前記露出した接続部との間に電流が発生することによって前記露出した接続部がコーティングされる、処理方法。

【請求項 2】

前記露出した接続部が、銅、アルミニウム、および金のうちの少なくとも 1 つから形成されている請求項 1 に記載の処理方法。

【請求項 3】

前記設定するステップは、前記露出した接続部を前記第 1 の電位に接続させることを含む請求項 1 に記載の処理方法。

【請求項 4】

前記設定するステップは、前記露出した接続部がグラウンド電位に設定されるように該露出した接続部を接続しない状態にすることを含む請求項 1 に記載の処理方法。

【請求項 5】

前記電気泳動用の溶液には、有機樹脂と脱イオンメジアンとが含まれている請求項 1 に記載の処理方法。

【請求項 6】

前記有機樹脂がポリマーである請求項 5 に記載の処理方法。

【請求項 7】

前記膜を硬化させるステップをさらに含む請求項 1 に記載の処理方法。

【請求項 8】

第 1 の硬化した前記膜の上に第 2 の膜を電気泳動めっきするステップをさらに含み、前記第 1 の膜と前記第 2 の膜とを複合させた厚さが均一な厚さである請求項 7 に記載の処理方法。

【請求項 9】

前記デバイスが、その上にオリフィス板を形成した少なくとも 1 つの基板と、該基板の表面上に配置されたボンディングパッドに電気接続された少なくとも 1 つの加熱要素とを備えたサーマルインクジェットデバイスである請求項 1 に記載の処理方法。

【請求項 10】

前記露出した接続部が、前記フレキシブルテープ回路上の導電トレースと、前記第 1 のデバイス上のボンディングパッドと、前記トレースと前記パッドとの間のボンディングビームとを含む請求項 9 に記載の処理方法。

【請求項 11】

前記膜の均一な厚さが、前記第 1 の電位と前記第 2 の電位との間の電圧差によって決まるようになっている請求項 1 に記載の処理方法。